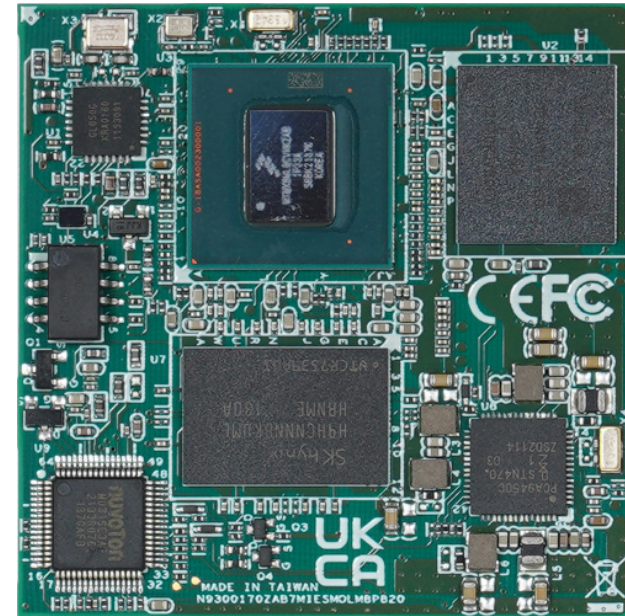


Embedded Module

Open Standard Module™ - iesy i.MX8M Plus OSM-LF

Technical Concept

- ▶ Prozessor: NXP i.MX8M Plus
- ▶ Arbeitsspeicher: 2GB
- ▶ Flash Speicher: 16GB eMMC
- ▶ Abmessung: 45 mm x 45 mm
- ▶ Footprint: OSM Size-L
Land Grid Array (LGA) mit 662 Kontaktpunkten
- ▶ Spannungsversorgung: 5V über LGA Kontakte
- ▶ Software: Linux basiertes BSP (Yocto)
- ▶ Temperaturbereich:
 - > Im Betrieb: -40 °C bis +85 °C
 - > Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- ▶ Funktionen & Schnittstellen
 - > 2x Ethernet
 - > 4x USB 2.0
 - > 1x USB 3.0
 - > 4x UART
 - > 8x GPIO
 - > 2x SPI
 - > 2x I2c
 - > 1x I2S
 - > 2x SDIO
 - > 2x CAN
 - > 1x JTAG
 - > 4x PWM
 - > 1x DSi, 1x CSI
 - > 1x PCIe
 - > 1x HDMI
 - > 1x LVDS



Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität**, **Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.



iesy.com/osm